

## Presseinformation

### **Inspektionstechnologien von Viscom live auf der productronica in München**

*Hannover, 27. September 2021* – Die Viscom AG präsentiert auf der diesjährigen productronica ihre neuesten Systeme und Lösungen für unterschiedlichste Prüfaufgaben der Elektronikindustrie. Expertinnen und Experten aus dem Unternehmen informieren am Messestand **A2.177** darüber, wie sich in der Fertigung genaueste Fehlererkennung, exaktes Messen und intelligentes Auswerten nahtlos zu perfekten und nachhaltigen Inspektionsabläufen ergänzen.

Die vernetzte Produktion von Flachbaugruppen und anderen elektronischen Komponenten erfordert ein immer höheres Maß an rundum zuverlässiger Prüfung der Produktqualität. Künstliche Intelligenz und herstellerübergreifende Kommunikationsabläufe zwischen den eingesetzten Produktionssystemen halten zunehmend Einzug in die automatisierte Fertigung und ihre Prozesse. Viscom zeigt vom 16. bis 19. November 2021 auf der productronica in München eine ganz besondere Auswahl seiner Inspektionstechnologien inklusive modernster Lösungen zur kontinuierlichen statistischen Überwachung einzelner Fertigungsschritte und Unterstützung von Standards wie IPC HERMES 9852 und IPC CFX. Die internationale Fachmesse findet, nach aktuellem Stand und zur großen Freude aller Beteiligten, „live“ mit Besucherinnen und Besuchern vor Ort statt. Dies wird aller Voraussicht nach dank entsprechender Hygienevorkehrungen und anderer Vorsichtsmaßnahmen möglich sein.

„Wir haben während der Pandemie die Zeit genutzt und unsere Innovationen weiter vorangetrieben. Dabei fokussierten wir uns vor allem auf unterschiedlichste Anforderungen im Bereich des immer wichtiger werdenden 3D-Inline-Röntgens und können heute auf diesem Gebiet besonders fortschrittliche Ergebnisse vorweisen“, informiert Torsten Pelzer,

Gesamtvertriebsleiter der Viscom AG. Hier geht es primär um die neue iX7059-Generation der Inline-Röntgensysteme von Viscom. Sie deckt eine Vielzahl von heutigen und zukünftigen Anforderungen ab und bietet als eine ihrer Besonderheiten flexible Prüfkonzeppte, die sich nicht nur auf die klassische Leiterplatte beschränken. Aus dieser neuen Serie ist auf der productronica das 3D-AXI-System iX7059 Heavy Duty Inspection zu sehen. Es zeichnet sich vor allem durch ein schnelles Handling bis zu 40 kg schwerer Prüfbobjekte und modernste Röntgentechnologie mit hoher Durchstrahlung aus. Die iX7059 Heavy Duty Inspection ist insbesondere auf eingehauste Komponenten und die Anforderungen der Leistungselektronik zugeschnitten. Einsatzfelder sind z. B. die Elektromobilität, Telekommunikation und erneuerbare Energien. Mit diesen Vorteilen und Eigenschaften hat die iX7059 Heavy Duty Inspection bereits einen New Product Introduction (NPI) Award 2021 von CIRCUITS ASSEMBLY gewonnen.

Die leistungsstarke Computertomografie der iX7059-Systeme liefert u. a. dank einer neuen Generation von Flachbilddetektoren exzellente Schichtbilder und bietet damit eine optimale Darstellung und eine sehr einfache Verifikation. Das innovative dynamische 3D-Bildaufnahmeverfahren Evolution 5 ermöglicht in wenigen Sekunden hundertfache Bildaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven für eine eindeutige dreidimensionale Analyse. Beispielsweise können Voids in Flächenlötungen bei zu großer Anzahl oder bei zu großem Durchmesser Überhitzung zur Folge haben, da sie eine einwandfreie Wärmeableitung verhindern. Sie werden im Rahmen der Inspektion hinsichtlich ihrer Größe und ihrem prozentualen Anteil an der Gesamtfläche der Lötstelle vermessen. Ebenfalls wird ihre Anzahl genauestens ermittelt. Weitere Fehlerarten, die von der iX7059 Heavy Duty Inspection sicher erkannt werden, sind Beschädigungen, verdrehte, fehlende und falsche Bauteile sowie Füllgrade und Pinhöhen bei THT-Lötstellen.

Für das schnelle und präzise Inline-Röntgen klassischer Leiterplatten ist auf dem Messestand von Viscom das international bereits mehrfach preisgekrönte 3D-AXI-System X7056-II ausgestellt. Es ist auch als kombinierte Inspektionslösung mit vollumfänglicher zusätzlicher 3D-AOI-Sensorik konfigurierbar und wird heute weltweit bei Kunden von Viscom für anspruchsvollste Prüfaufgaben eingesetzt. Besucherinnen und Besucher, die sich wiederum für ein Offline-Röntgensystem interessieren, um Aufgaben wie hochgenaue Prüfungen von Prototypen, Stichproben oder Kleinserien anzugehen, werden am MXI-System X8011-II PCB über die vielfältigen Möglichkeiten hinsichtlich der gegebenen Analysefunktionen und des flexiblen Probenhandlings informiert.

Als Vertreter seines ebenfalls sehr nachgefragten 3D-AOI- und 3D-SPI-Angebots präsentiert Viscom auf der productronica die S3088 DT. Das kompakte System ist auf zweispurigen Betrieb ausgelegt und passt sich flexibel an unterschiedliche Spurweiten an. Es kann zudem auch als Single-Track-Ausführung verwendet werden und ist dann in der Lage, selbst größte Leiterplatten zu inspizieren.

Die 3D-AOI-Version der S3088 DT bietet neben dem 3D-Sensor acht hochauflösende Schrägansichten und höchste orthogonale Auflösung, um die sichere Inspektion kleinster Bauteile bis hin zu 01005 zu ermöglichen. Das große Sichtfeld gewährleistet schnellste Inspektion zur effektiven Taktzeitreduzierung. Die Prüfprogrammerstellung geht besonders intuitiv und einfach von der Hand. Smarte Inspektionsalgorithmen ermitteln exakt, ob z. B. auch die Lötstelle des kleinsten elektronischen Bauteils noch den Anforderungen entspricht oder doch schon zu mager gelötet ist. Das System zählt zu den Gewinnern der NPI Awards 2020.

Viscom präsentiert auf der productronica auch seine neueste 3D-SPI-Technologie. Interessierte, die speziell mehr darüber erfahren wollen, können sich an derselben S3088 DT neben den 3D-AOI-Funktionen die für 3D-SPI gegebenen vielseitigen Möglichkeiten der Vermessung, Analyse und automatisierten Kommunikation in der Fertigungslinie vorführen lassen. Denn das System von Viscom ist auch als Variante für diesen in der Fertigung sehr wichtigen Prozessschritt erhältlich.

Ein spezieller Bereich der optischen Fehlererkennung ist die Drahtbond-Inspektion. Auf diesem Gebiet ist Viscom hinsichtlich des Prüfumfanges seit vielen Jahren führend und informiert auf der Messe auch bei dieser Technologie über seine neuesten zukunftsorientierten Lösungen: Anhand des Systems S6056BO werden die besonders fortschrittlichen Entwicklungen im Bereich der 3D-Inspektion vorgestellt. Sie ermöglichen sowohl für Dickdrähte als auch für Dünndrähte wichtige zusätzliche Informationen über die tatsächliche Produktqualität, sind sehr effektiv im Linientakt einsetzbar und helfen, die Anzahl von Pseudofehlern noch weiter zu reduzieren.

**Bilder:** iX7059 Heavy Duty Inspection; X7056-II; X8011-II PCB; S3088 DT; S6056BO

## **Über Viscom**

Die 1984 gegründete Viscom AG gehört im Bereich der Baugruppeninspektion in der Elektronikfertigung zu den führenden Anbietern weltweit. Das Unternehmen, mit Hauptsitz und Fertigungsstandort in Hannover, entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme aus den Bereichen AOI, SPI, AXI, MXI, Bondinspektion sowie CCI für die Schutzlackinspektion. In punkto Genauigkeit und Schnelligkeit setzen die Systeme aus Hannover Maßstäbe. Das Produktspektrum umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung für kleine und mittelständische Unternehmen sowie die Großserienfertigung. Die Systeme von Viscom werden bei der 100%igen automatischen Inspektion von elektronischen Baugruppen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Produktion von Automobilelektronik, der Luft- und Raumfahrttechnik oder bei der Fertigung von Telekommunikationselektronik.

Im Fokus der Produktentwicklung stehen zudem kundenspezifische Systementwicklungen sowie die Vernetzung mit anderen Fertigungsprozessen für Smart-Factory-Anwendungen. Um dies zu erreichen, investiert die Viscom AG verstärkt in die eigene Software- und Hardware-Entwicklung, die immer wieder neue Standards in der Inspektionstechnologie definiert.

Der internationale Vertrieb erfolgt über ein breites Netz aus eigenen Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten. Ein Serviceteam aus eigenen Technikern und Anwendungsspezialisten nimmt die Viscom-Anlagen weltweit in Betrieb und bietet Instandhaltung, Umbau und Modernisierung aus einer Hand. Darüber hinaus werden systemspezifische Schulungen für Bediener, Programmierer und das Wartungspersonal der Kunden angeboten. Dabei stellen erfahrene Ingenieure und Techniker aus Applikation und Service ihr Expertenwissen den Teilnehmern zur Verfügung.

Seit 2006 ist die Viscom AG an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867) notiert.